

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年3月3日(03.03.2022)



(10) 国際公開番号

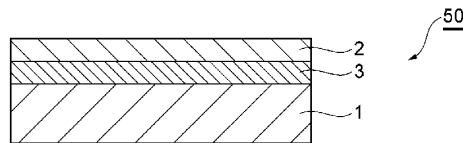
WO 2022/044921 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 65/02 (2006.01) *B32B 27/32* (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01) *B65D 75/34* (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01) *B65D 85/86* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/030215
- (22) 国際出願日: 2021年8月18日(18.08.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-140976 2020年8月24日(24.08.2020) JP
特願 2020-212246 2020年12月22日(22.12.2020) JP
- (71) 出願人: デンカ株式会社 (DENKA COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 名波 圭祐 (NABA Keisuke); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 中島 剛介 (NAKAJIMA Gosuke); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 阿津坂 高範 (ATSUSAKA Takanori); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 徳永 久次 (TOKUNAGA Hisatsugu); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP).

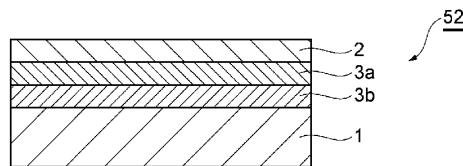
(54) Title: COVER TAPE AND ELECTRONIC-COMPONENT PACKAGE

(54) 発明の名称: カバーテープ及び電子部品包装体

(a)



(b)



(57) Abstract: A cover tape comprising at least a base layer and a heat seal layer, wherein the heat seal layer comprises copolymers (A) of a styrene-based hydrocarbon and a conjugated-diene-based hydrocarbon, the (A) ingredient comprises a block copolymer (A-1) of 10-50 mass%, excluding 50 mass%, styrene-based hydrocarbon and 50-90 mass%, excluding 50 mass%, conjugated-diene-based hydrocarbon and a block copolymer (A-2) of 50-95 mass% styrene-based hydrocarbon and 5-50 mass% conjugated-diene-based hydrocarbon, the content of the (A-1) ingredient being 35-60 mass% with respect

[続葉有]

WO 2022/044921 A1

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

to the whole heat seal layer, and the mass ratio of the (A-2) ingredient to the (A-1) ingredient being 0.30-1.0.

(57) 要約: カバーテープは、基材層と、ヒートシール層と、を少なくとも有し、ヒートシール層が、スチレン系炭化水素と共役ジエン系炭化水素との共重合体 (A) を含有し、(A) 成分が、スチレン系炭化水素 10 質量%以上 50 質量%未満と共役ジエン系炭化水素 50 質量%超 90 質量%以下とのブロック共重合体 (A-1) と、スチレン系炭化水素 50 質量%以上 95 質量%以下と共役ジエン系炭化水素 5 質量%以上 50 質量%以下とのブロック共重合体 (A-2) と、を含み、(A-1) 成分の含有量が、ヒートシール層全量を基準として、35~60 質量%であり、(A-1) 成分に対する (A-2) 成分の質量比が、0.30~1.0である。